

平成 19 年度事業報告書

自: 平成 19 年 4 月 1 日 至: 平成 20 年 3 月 31 日

1. 全般

- (1) 平成18年度に制定した学会の理念・ビジョンおよびコアコンピタンスに基づいた施策を実行し、発展構想実現に向けた活動を推進した。特に、運営業務の効率化と透明性を高めることで学会活動の活性化と会員の増強につながる施策に取り組んだ。
- (2) 学会の継続的な発展と円滑な運営のため、会員サービスをさらに充実する基盤を築いた。運営の効率化について理事会の指導性が発揮できるよう、規程と内規を整備して運営業務の定型化と透明化を進めた。
事務局内の業務効率向上と会計処理の簡素化を進めるため、事務局におけるIT環境の再構築に着手し、会計処理ソフトの試験運用を開始した。
- (3) 本学会のプレゼンスを高め、国際交流活動を推進する足がかりとして、実装技術分野で世界的な規模の学会であるIMAPSのWLC会議に会長が出席して本学会の活動を発表することにより、海外にアピールした。
- (4) 関西支部、九州支部の運営の透明性と独自性を確保するため、支部運営内規などを整備して地域における情報発信・交流を盛んにし、企業規模に捉われない活動支援と会員の拡大に努めた。
- (5) 学会設立から10年が経過したことを記念する行事を立案し、平成20年11月に10周年記念行事を実施する準備を進めた。

2. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催 (定款第 4 条第 1 号関係)

- (1) 国際会議「ICEP 2007」(組織委員長 日本電気 嶋田勇三氏)
2007.4.18～20、品川プリンスホテルにて、IEEE CPMT Japan Chapter と共催で、第 11 回の国際会議「ICEP 2007」を開催。
「A New JISSO Paradigm Shift, Messages from Japan」をメインテーマに、海外 23 件 (内、招待講演 1 件、フォーカストセミナー 1 件) を含む総計 80 件の論文発表と国際交流会を開催。
論文集(A4 判・432 頁)を刊行。参加者 258 名 (内、海外 46 名)。
- (2) 「2007 最先端実装技術シンポジウム・2007 マイクロエレクトロニクスショー」
2007.5.30～6.1、最先端実装技術シンポジウムとマイクロエレクトロニクスショー展示会を東京ビッグサイトにて開催。JPCA Show 2007(電子回路工業会主催)および JISSO PROTEC2007(ロボット工業会)と共同開催の相乗効果で、多くの参加者を集めた。
マイクロエレクトロニクスショー展示会を「最先端実装技術・パッケージング展」と称して開催。出展社 35 社、89 小間であり、会期中の延べ来場者は 131,355 人(登録者 39,812 名)。
最先端実装技術シンポジウムは、チップ積層、高周波基板の設計・製造、FPC、部品内蔵基板、MEMS、光回路実装などの最先端実装技術に関して 3 日間で講演 30 件、聴講者 655 名。
- (3) 「第 17 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム」(組織委員長 甲南大学 縄舟秀美教授)
2007.9.13～14、甲南大学にて開催。講演 73 件(一般講演 71 件 招待講演 2 件)。
招待講演は「SiP 基板標準化のための SiPOS 活動」(福岡大学 友景肇教授)と「次世代エレクトロニクス実装とめっき技術」(新光電気工業 若林信一氏)。参加者 488 名。
- (4) 「第 22 回エレクトロニクス実装学会講演大会」(実行委員長 東京大学 須賀唯知教授)
2008.3.17～19、東京大学本郷キャンパスにて開催。18 件の招待講演、2 件の特別講演、111 件の一般講演のほか、IEEE-CPMT セッションとして 4 件の特別招待講演を実施した。
【特別講演】
・「エルピーダの半導体戦略 日本のエンジニアよ元気を出せ」
エルピーダメモリ(株) 代表取締役社長兼 CEO 坂本幸雄氏
・「開かれたものづくりと能力構築」
東京大学ものづくり経営研究センター センター長 藤本隆宏教授

本学会活動の紹介を狙いとして、この講演に限り会員外にも低額有料、学生無料で聴講できるようにした。会期中の参加登録者は 827 名と盛況であった。

3. 調査・研究活動 (定款第 4 条第 2 号関係)

(1) ワークショップの開催

関西ワークショップ 2007 の開催

テーマを「JISSO 革命、日本から世界への発信」として、コープ・イン・京都で 2007.7.6 に開催。特別講演は「ウエハプロセスを変革する新実装技術、シリコン貫通電極 (TSV)」(長野県工科短期大学 校 傳田 精一教授)。20 件のポスター発表。参加者 79 名。

2007 ワークショップ(修善寺)の開催

メインテーマを「商品価値を高める先進実装技術」、サブテーマを「顧客の要求を満たす実装技術を探る」として、日本のエレクトロニクス産業がグローバルな競争に勝ち抜くためのキーテクノロジーとなる実装技術についてポスター形式による発表(35 件)をラフォーレ修善寺にて、2007.11.8~9、1 泊 2 日で開催。招待講演は「LSI 設計から見た 3 次元 SiP」(東京大学 桜井貴康教授)、「デジタル家電統合プラットフォーム UniPhier (ユニファイエ)」(松下電器産業 技監 柿沼雄二氏)の 2 件。ナイトセッションは「技術ベースのビジネスと組織 FeliCa 普及秘話:汗と涙と」(フェリカネットワークス 副社長 倉員桂一氏が講演)。参加者 101 名。

(2) 技術委員会の開催行事

材料技術委員会の公開研究会

テーマ「次世代インテリジェント実装材料」

2007.11.29、東京・国立オリンピック記念青少年総合センターにて開催。

基調講演 1 件、講演 8 件、参加者 90 名。

電磁特性技術委員会サマーセミナーの開催

テーマ「高速伝送と電磁シールド - シールドからなぜ放射がでるのか - 」

2007.8.28、科学技術館 サイエンスホールにて開催。講演 10 件、参加者 208 名。

(3) 公開研究会の開催

マイクロ・ナノファブ리케이션研究会(配線板製造技術委員会)

・第 1 回公開研究会

テーマ「マイクロ・ナノファブ리케이션を志向した材料, プロセス技術」

2007.5.15、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。

講演 5 件、参加者 104 名。

・第 2 回公開研究会

テーマ「マイクロ・ナノファブ리케이션を志向した材料, プロセス技術(2)」

2007.9.28、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。

講演 5 件、参加者 96 名。

・第 3 回公開研究会

テーマ「マイクロ・ナノファブ리케이션を志向した材料及び表面改質技術」

2007.12.20、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。

講演 5 件、参加者 86 名。

超高速高周波エレクトロニクス実装研究会(電磁特性技術委員会)

・第 1 回公開研究会

2007.5.18、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 7 件、参加者 46 名。

・第 2 回公開研究会

2007.8.3、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 7 件、参加者 78 名。

・第 3 回公開研究会

2007.11.16、東京理科大 森戸記念館にて開催。講演 7 件、参加者 52 名。

- ・第 4 回公開研究会
2008.2.15、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 7 件、参加者 64 名。
電子部品研究会(電子部品・実装技術委員会)
- ・第 1 回公開研究会
テーマ「エネルギーデバイスの最新動向」
2007.8.23、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 5 件、参加者 58 名。
- ・第 2 回公開研究会
テーマ「実用化が加速する MEMS 技術」
2008.2.13、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 5 件、参加者 60 名。
先進実装技術研究会(電子部品・実装技術委員会)
- ・第 1 回公開講演会
テーマ「Jisso ロードマップ報告」
2007.6.19、横浜国立大学 教育文化ホールにて、横浜国大実装技術研究会と共催。
講演 4 件、参加者 93 名。
- ・第 2 回公開講演会
テーマ「表面マイクロ接合技術」
2007.9.28、東京大学弥生講堂にて電子材料技術協会表面技術研究会と共催。
講演 5 件、参加者 73 名。
- ・第 3 回公開講演会
テーマ「実装設備関係」
2008.1.22、横浜国立大学 教育文化ホールにて、横浜国大実装技術研究会と共催。
講演 5 件、参加者 47 名。
- ・第 4 回公開講演会
テーマ「微細配線形成技術」
2008.3.14、横浜国立大学 教育文化ホールにて、横浜国大実装技術研究会と共催。
講演 3 件とポスターセッション
エレクトロケミカル(イオン)マイグレーション評価法研究会(信頼性解析技術委員会)
- ・第 1 回公開講演会
「エレクトロケミカルマイグレーション評価方法」の改定版説明と研究会活動状況報告
および講演。
2007.10.17、国立オリンピック記念青少年総合センターにて開催。
依頼講演 2 件、参加者 145 名。
錫ウイスカ研究会(信頼性解析技術委員会)
- ・第 1 回公開講演会
テーマ「錫ウイスカ発生の要因とその抑制のための解析・分析技術」
2007.10.29、トッパンホームズビルにて開催。
依頼講演 8 件、参加者 76 名。
- EPADs(Embedded Passive and Active Devices)研究会(配線板製造技術委員会)
- ・第 1 回公開研究会
テーマ「部品内蔵基板の最新技術動向」
2007.10.26、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催
基調講演 1 件、招待講演 1 件、一般講演 3 件、参加者 110 名。
- ・第 2 回公開研究会
テーマ「部品内蔵基板とこれを支える要素技術」
2008.2.22、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。
WG 活動報告、基調講演 1 件、一般講演 4 件、参加者 100 名。

システム実装 CAE 技術研究会 (回路・実装設計技術委員会)

・第 1 回公開研究会

テーマ「チップ・パッケージ・ボード間協調設計のためのシミュレーション技術」

2007.5.30、東京ビッグサイトにて、JPCA ショーに併設開催。講演 5 件、参加者 102 名。

・第 2 回公開研究会

テーマ「システム実装を支える設計・シミュレーション技術」

チップ・パッケージ・ボード間協調設計における性能評価および設計最適化技術

2007.12.12、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 5 件、参加者 57 名。

光回路実装技術研究会 (光回路実装技術委員会)

・第 31 回 OPT 公開研究会

2007.6.7、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 4 件、参加者 19 名。

・第 32 回 OPT 公開研究会

特集「光学ポリマーの新展開」

2007.10.2、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 4 件、参加者 22 名。

・第 33 回 OPT 公開研究会

特集「光インターコネクションの新展開」

2007.11.27、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 4 件、参加者 32 名。

・第 34 回 OPT 公開研究会

特集「光配線/光部品実装技術の開発状況」

2008.1.29、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。講演 4 件、参加者 25 名。

エコデザインと実装研究会

テーマ「環境調和技術の未来 不都合な現実とイノベーション」

2007.6.1、東京ビッグサイトにて、JPCA ショーに併設開催。

基調講演 1 件、一般講演 5 件、参加者 50 名。

4. 普及・啓発活動 (定款第 4 条第 3 号関係)

(1) 実装技術総合講座

2007.10.18～19、エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。

講師 福岡義孝氏(ウェイスティ)、受講者 31 名。

(2) PWB 設計実技講習会

2007.12.6～7、エレクトロニクス実装学会会議室にて、プリント配線板技能検定試験(設計技能士)を受験される設計技能者向けの設計実技講習会を開催。受講者 12 名。

(3) 先端技術セミナー

第 44 回定例セミナー (2007.7.20)

テーマ「半導体パッケージ・モジュールを支える最新技術動向」

エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。基調講演は「半導体パッケージの将来展望」(明星大学 大塚寛治教授)。講演 8 件、参加者 112 名。

第 45 回定例セミナー (2007.10.31)

テーマ「カーエレクトロニクスの最新動向」

東京・国立オリンピック記念青少年総合センターにて開催。基調講演「カーエレクトロニクスを支える実装技術への期待と要望」(トヨタ自動車 服部雅之氏)。講演 7 件、参加者 75 名。

第 46 回定例セミナー (2008.3.28)

テーマ「プリンタブルエレクトロニクスの最新動向と今後の展望」

エレクトロニクス実装学会会議室にて開催。基調講演は、「インクジェット配線技術のエレクトロニクスへの応用の最新動向と将来展望」(大阪大学 菅沼克昭教授)。講演 7 件、参加者 85 名。

5. 情報収集および提供活動 (定款第 4 条第 4 号関係)

(1) 「エレクトロニクス実装学会誌」の発行

学会誌を 7 回発行 (Vol.10 No.3~7 および Vol.11 No.1~2)。

会員の技術・研究活動の成果として発表される研究論文、総合論文、速報論文、技術論文、解説等を学会誌に掲載し、エレクトロニクス実装の研究と技術に関する最新の情報を会員に提供した。

学会誌 Vol.11 No.2 から“学会運営について”のコーナーを設け、学会の運営状態の情報公開に努めた。

論文投稿を促進するため、投稿規程の見直しを行った。

(2) 英文論文誌の発行準備

英文論文誌を発行するための編集委員会を設立し、20 年度発行に向けた準備をした。19 年度は、エレクトロニクス実装学会誌の Vol.11 No.1~2 に ICEP 2007 で発表された講演発表から英文論文にしたものを小特集として掲載。

6. 地域交流活動の促進 (定款第 4 条第 6 号関係)

(1) 関西支部における各種事業の開催

第 6 回若手研究会セミナー

テーマ「界面と接着現象の基礎」

2007.7.26、大阪大学中之島センターにて開催。参加者 68 名。

第 5 回見学会/技術講演会

隆祥産業株式会社香川工場見学と技術講演会を 2007.11.27 に開催。参加者 28 名。

MEMS やデバイスの超微細構造物に用いる超臨界 CO₂ による洗浄・乾燥装置を見学。

技術講演会は「MEMS の研究開発動向と京都大学における MEMS 研究・教育」(京都大学・田畑修教授)と「超臨界 CO₂ 洗浄・乾燥プロセスのライン導入」(隆祥産業株式会社・三宅幸一氏)。

第 7 回若手研究会セミナー

テーマ「実装部の信頼性評価の基礎」

2008.1.24、大阪大学中之島センターで開催。講演 2 件、参加者 44 名。

第 4 回技術講演会

テーマ「3次元積層技術を支える接合技術の最新動向」

2008.2.15、大阪大学中之島センターで開催。参加者 68 名。

(2) 九州支部体制の構築

九州支部規約を基に具体的な活動指針を示す運営内規を作成し、活動の基盤を整備した。

7. 内外機関等との交流・協力活動 (定款第 4 条第 5 号関係)

(1) IMAPS との連携強化

IMAPS の Affiliate 会員を募集

本学会の会員に限り、特別会費で IMAPS 会員となれる制度を作り 307 人が入会。

WLC-ALC(World Liaison Committee-Asia Liaison Committee)を 2007.4.18 に開催し、アジア並びに欧米の委員との情報交換を行った。

IMAPS Korea (韓国) との連携強化

IMAPS Korea と実装に関する技術交流を促進する MOU 協定を 2007.4.18 に締結した。

IMAPS-WLC(World Liaison Committee)

塚田会長が 2007.11.10、サンノゼで行われた IMAPS-WLC に参加し、本学会の活動を発表した。

IMAPS と対等な立場であることの理解を得、ICEP 国際会議開催に一層の支援が得られた。

(2) JPCA Show2007/JISSO PROTEC2007 とのコラボレーション

例年、電子回路工業会と同時開催している JPCA Show/マイクロエレクトロニクショーに、ロボット工業会の JISSO PROTEC 展も加えて、3 団体の同時開催展示会を 2007.5.30~6.1、東京ビッグサイトにて

開催した。また、最先端実装技術シンポジウムと公開研究会 2 件(エコデザインと実装研究会、システム実装 CAE 研究会)を併設開催した。

(3) 関連学協会の各種事業に協賛

1. 精密工学会 画像応用技術専門委員会, View 2007 ビジョン技術の実利用ワークショップ, 2007.12.6~7, パシフィコ横浜アネックス・ホール
2. 日本機械学会 「構造解析のための有限要素法入門」講習会, 2007.7.9~10, 横浜国立大
3. 応用物理学会 第 41 回サマーセミナー(2007)光とナノスケールの世界, 2007.8.27~28, 富士教育研修所
4. 高温学会 エレクトロニクス実装におけるスマートプロセス・評価技術シンポジウム, 2007.9.28, 大阪大学荒田記念館
5. 溶接学会 Mate 2008, 14th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”, 2008.2.5~6, パシフィコ横浜
6. 電子情報通信学会 集積回路研究専門委員会第 11 回システム LSI ワークショップ, 2007.11.19~21, 北九州市
7. IEEE CPMT Society Japan Chapter, ワークショップ(3D Integration by Heterogeneous Wafer Bonding Technology シンポジウム), 2007.10.15~16, 東京大学
8. エコデザイン学会連合 EcoDesign 2007, 2007.12.10~13, 日本科学未来館
9. 日本時計学会 2007 年度マイクロメカトロニクス学術講演会, 2007.9.7, 中央大学
10. 精密工学会 動的画像処理実利用化ワークショップ 2008, 2008.3.6~7, 中京大学
11. 日本印刷学会 2007 年度 E&S 研究会セミナー, 2007.10.26, 日本印刷会館
12. 応用物理学会 2008 年固体素子・材料コンファレンス, 2008.9.23~26, つくば国際会議場
13. 電気学会 平成 20 年電気学会 電子・情報・システム部門大会, 2008.8.20~22, はこだて未来大学
14. 日本能率協会 第 22 回 2008 EMC・ノイズ対策技術シンポジウム, 2008.4.16~18, 幕張メッセ
15. 日本能率協会 第 8 回 2008 熱設計対策技術シンポジウム, 2008.4.16~18, 幕張メッセ
16. NPO 法人サーキットネットワーク C-NET 定期講演会, 2008.3.12, 回路会館
17. 応用物理学会 2008 年国際ワークショップ (2008 IWDTF), 2008.11.5~7, 東京工業大学
18. 日本セラミックス協会 第 21 回秋季シンポジウム, 2008.9.17~19, 北九州国際会議場
19. 有機テクノロジー実行委員会 オルガテクノ 2008 (有機テクノロジー展 / 有機テクノロジー国際会議), 2008.10.28~29, つくば国際会議場
20. 日本能率協会 TECHNO-FRONTIER 2008, 2008.4.16~18, 幕張メッセ

8. 事務局体制の整備・強化

- (1) 学会事務局の作業効率化のために IT 化を進めるとともに、決裁管理、公印管理、文書管理の規程を整備して業務管理を適正化した。また、学会活動をさらに活性化するため、懇親会開催のための内規および幹部会の位置づけを明確にする規程を制定した。
- (2) 「高齢者雇用安定法の改正」に準じて、事務局職員を定年後の満 63 歳まで継続雇用できるようにするために就業規則を改定した。また、同法に対応するために再雇用の内規についても整備した。

*平成 20 年 3 月 31 日現在の会員数

正会員	2,983 名(前年同期比 33 名増)
学生会員	140 名(前年同期比 3 名増)
賛助会員	219 社(前年同期比 3 社減)